



英伟达发布NVHBM重构内存架构， ABF载板交期拉长

AI算力行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年09月01日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

英伟达推出定制化高带宽内存技术NVHBM，AWS计划2027至2028年额外部署200万颗GPU

当地时间8月26日，英伟达宣布推出新一代定制高带宽内存技术NVHBM，并将其纳入NVLink Fusion生态。该技术核心设计颠覆了传统HBM架构，将英伟达自研的定制化内存控制器从XPU运算晶粒转移到HBM堆叠中的Base Die上。英伟达宣称，相较标准HBM4E可实现最高30%的内存带宽提升、15%的HBM功耗降低，并可释放最多25%的XPU运算晶粒面积用于计算单元。此外，新设计的定制化物理层接口比JEDEC标准HBM4E减少了67%的I/O面积，简化了先进封装中硅中介层的布线复杂度。与此同时，英伟达与AWS宣布扩大合作，双方计划于2027年至2028年间在AWS全球基础设施中额外部署200万颗英伟达GPU，覆盖Blackwell Ultra、Rubin及Rubin Ultra架构。

ABF载板2026年产能已全部预定完毕，交期拉长至12至14个月，2028年供需缺口预计扩大至42%至51%

8月28日消息，根据semianalysis最新研究，2026年六家主要ABF基板供应商的产能已全部预定完毕，整体交期拉长至12至14个月，相比2025年初的约6至8个月延长了近一倍。推动交期持续拉长的核心原因在于，新一代ASIC与GPU平台规格快速升级，先进封装芯片体积持续放大，单颗芯片占用产线时间显著增加。以英伟达新一代Rubin GPU为例，其所需载板面积较前一代Blackwell增加达123%。与此同时，台积电CoWoS先进封装产能同步扩张，成为拉动载板需求的另一重要变量。ABF基板紧缺的另一大根源在于上游ABF增层膜供应极度集中，全球90%以上甚至95%的ABF增层膜供应由日本味之素一家公司掌握，味之素部分产能已被预订至2027年，新工厂计划2028年动工、2032年投产，2032年前无大规模新产能释放。市场研究机构预测，2026年下半年缺口约8%至10%，2027年扩大至21%至34%，2028年上看42%至51%。

随着ABF基板交期超过12个月，客户已开始洽谈2029年之后的长期产能承诺，部分二线供应商已开始通过竞标方式拍卖剩余产能。近期，味之素削减中国大陆市场30%供货量，使大陆ABF本土自给率不足5%的矛盾进一步凸显，加速了华正新材CBF膜、深圳纽菲斯NBF膜等本土厂商的替代进程。

建议关注：天孚通信、天准科技、兴森科技、华虹宏力、中芯国际、寒武纪。

公司代码	名称	2026-09-01 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
002436.SZ	兴森科技	34.55	0.08	0.26	0.44	431.88	132.88	78.52	买入
300394.SZ	天孚通信	251.77	2.61	4.18	5.53	96.46	60.23	45.53	买入
688003.SH	天准科技	77.88	0.39	0.91	1.27	199.69	85.58	61.32	未评级
688256.SH	寒武纪	1109	5.25	8.05	12.17	211.24	137.76	91.13	买入
688347.SH	华虹宏力	250.33	0.01	0.51	0.83	25033.00	490.84	301.60	增持
688981.SH	中芯国际	126.11	0.63	0.82	1.01	200.17	153.79	124.86	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

目录

CONTENTS

1. 算力板块周度行情分析
2. 行业动态
3. 公司公告

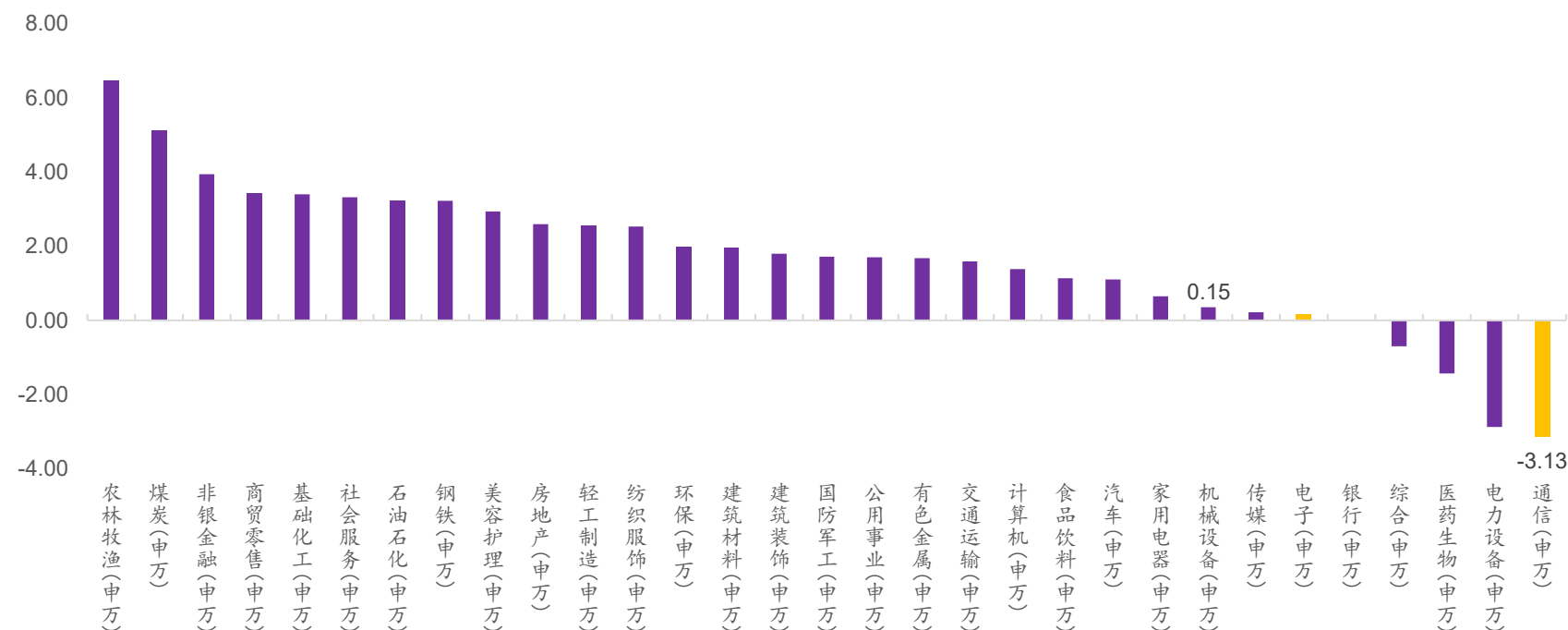
01 算力板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、申万一级行业周涨跌幅

跨行业比较，8月24日-8月28日当周，申万一级行业整体呈分化态势。其中电子行业上涨0.15%，位列第26位；通信行业下跌3.13%，位列第31位。

图表2：8月24日-8月28日申万一级行业周涨跌幅比较（%）

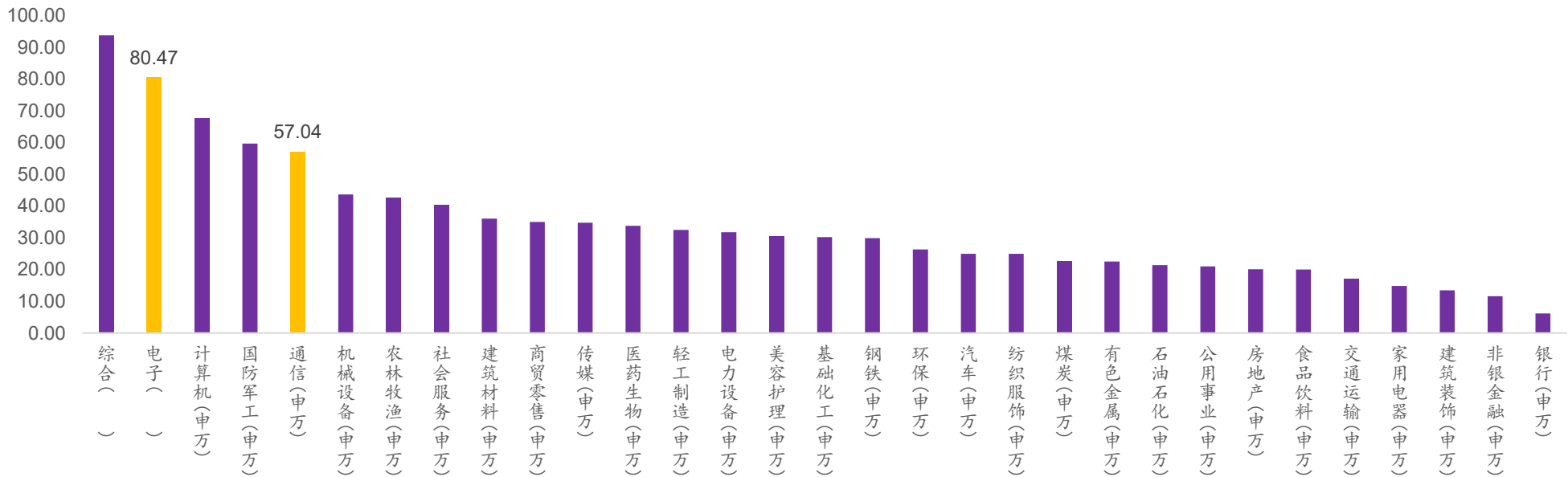


资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

跨行业比较，8月24日-8月28日当周，估值前三的行业为综合，电子和计算机行业，其中电子、通信行业的市盈率分别为80.47，57.04。

图表3：8月24日-8月28日申万一级行业市盈率比较

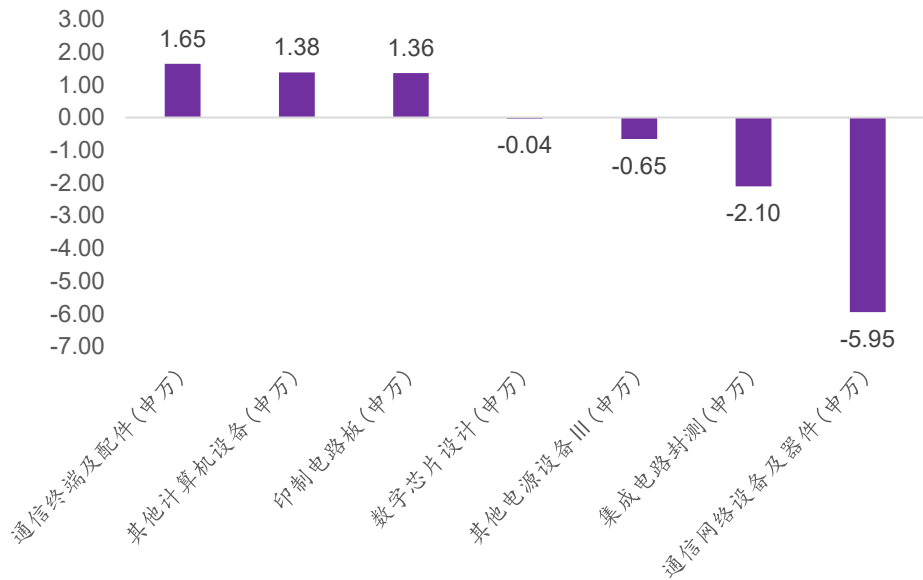


资料来源：wind，华鑫证券研究

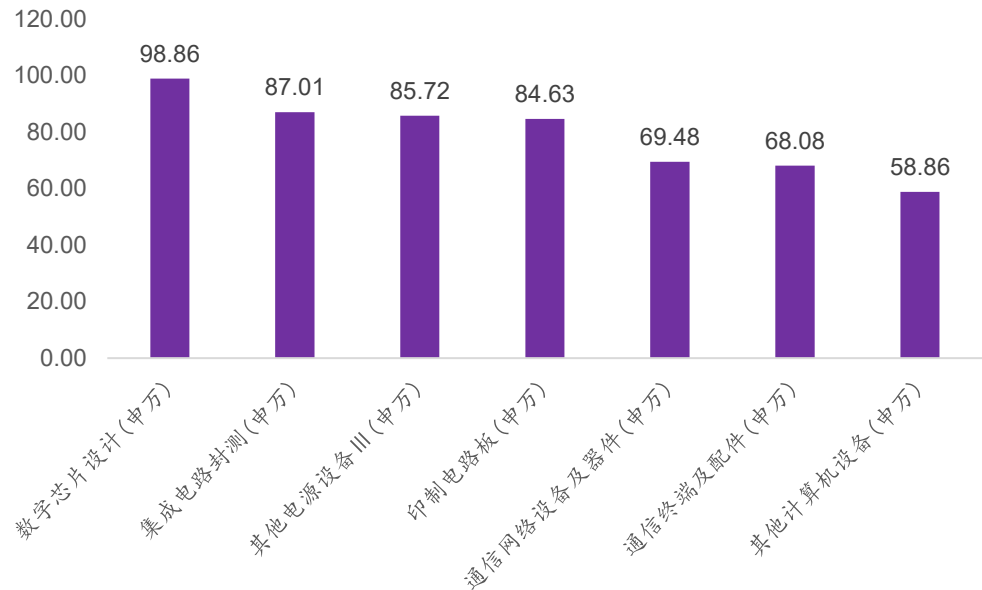
1.3、AI算力细分板块周度行情梳理

AI算力相关细分板块比较，8月24日-8月28日当周，AI算力相关细分板块呈分化态势。其中，通信终端及配件板块涨幅最大，达到1.65%。通信网络设备及器材板块跌幅最大，达到-5.95%。估值方面，数字芯片设计、集成电路封测和其他电源设备板块估值水平位列前三。

图表4：8月24日-8月28日AI算力相关细分板块周涨跌幅比较（%）



图表5：8月24日-8月28日AI算力相关细分板块市盈率比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万一级行业板块资金流向

上周申万一级行业资金流向情况：

上周电子板块主力净流出25.99亿元，主力净流入率为-0.10%，在31个申万一级行业中排第16名；通信板块主力净流出116.35亿元，主力净流入率为-1.34%，在31个申万一级行业中排第29名。

图表6：8月24日-8月28日申万一级行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW农林牧渔	4,218,959.87	3,993,625.02	225,334.85	1.52	2
SW美容护理	438,438.45	419,641.87	18,796.59	0.92	1
SW房地产	1,966,459.10	1,904,818.45	61,640.65	0.86	2
SW商贸零售	1,640,361.86	1,580,683.85	59,678.01	0.83	2
SW基础化工	14,946,742.08	14,519,195.34	427,545.59	0.77	4
SW社会服务	1,378,758.26	1,343,579.53	35,178.73	0.62	4
SW综合	393,859.41	384,143.05	9,716.35	0.60	2
SW汽车	7,269,911.55	7,131,597.74	138,313.81	0.53	-1
SW计算机	14,555,841.15	14,323,150.70	232,690.45	0.49	4
SW环保	1,836,069.26	1,809,613.89	26,455.37	0.37	-1
SW传媒	4,173,353.84	4,131,469.54	41,866.59	0.29	2
SW机械设备	24,295,660.64	24,068,010.97	227,649.67	0.29	-1
SW轻工制造	1,750,863.96	1,727,967.09	22,896.87	0.29	1
SW纺织服饰	1,475,152.52	1,458,670.95	16,481.57	0.26	3
SW有色金属	25,268,472.29	25,245,796.68	22,675.62	0.03	-1
SW电子	91,604,292.57	91,864,184.60	-259,892.03	-0.10	-1
SW非银金融	7,372,459.79	7,418,342.45	-45,882.66	-0.21	-2
医药生物	18,804,221.76	18,966,346.59	-162,124.83	-0.23	-1
SW建筑装饰	3,072,524.40	3,105,921.94	-33,397.53	-0.27	1
SW煤炭	1,528,789.12	1,573,998.63	-45,209.50	-0.62	-3
SW电力设备	20,728,695.58	21,238,848.14	-510,150.23	-0.71	-2
SW公用事业	4,099,173.52	4,230,190.06	-131,016.54	-0.77	-2
SW食品饮料	3,338,571.54	3,460,635.14	-122,063.59	-0.92	1
SW建筑材料	3,354,966.68	3,465,691.78	-110,725.09	-0.93	2
SW银行	4,553,208.81	4,706,926.26	-153,717.45	-1.08	-1
SW石油石化	2,345,190.53	2,447,742.33	-102,551.80	-1.15	1
SW钢铁	1,020,400.82	1,067,267.84	-46,867.02	-1.22	2
SW国防军工	4,644,142.72	4,873,136.64	-228,993.92	-1.22	-1
SW通信	34,148,034.04	35,311,572.50	-1,163,538.46	-1.34	-1
SW交通运输	2,494,746.04	2,667,937.31	-173,191.27	-1.54	-5
SW家用电器	2,727,114.42	2,874,538.35	-147,423.94	-1.57	-1

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、AI算力细分板块资金流向

AI算力相关板块资金流向情况：
上周其他电源设备Ⅲ板块主力净流入8.22亿元，主力净流入率为1.38%，在8个子行业中排第1名；通信网络设备及器件板块主力净流出117.08亿元，主力净流入率为-2.42%，在8个子行业中排第8名。

图表7：8月24日-8月28日AI算力相关行业资金流向情况

序号	行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
1	SW其他电源设备Ⅲ	1,884,936.51	1,802,727.62	82,208.89	1.38	-1
2	SW印制电路板	15,742,725.92	15,320,161.30	422,564.62	1.03	-1
3	SW通信终端及配件	2,466,502.06	2,410,649.19	55,852.87	0.66	-1
4	SW其他计算机设备	2,595,698.62	2,573,057.17	22,641.45	0.25	-1
5	SW集成电路制造	2,233,360.61	2,228,153.29	5,207.32	0.08	-1
6	SW集成电路封测	2,963,945.68	3,004,255.55	-40,309.87	-0.38	3
7	SW数字芯片设计	23,139,910.22	23,630,031.98	-490,121.76	-0.90	-1
8	SW通信网络设备及器件	22,706,301.39	23,877,091.12	-1,170,789.73	-2.42	2

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

随着 5G 通信、人工智能、大数据中心、汽车电动化和智能化等新兴技术的快速发展对 PCB 的需求在数量和质量上都提出了更高要求。例如，5G 基站建设需要大量高频、高速 PCB 板以实现信号的高速传输；汽车智能化使得汽车电子系统日益复杂，对车用 PCB 的可靠性和性能要求大幅提升。

过去几十年，PCB 产业经历了从欧美向日本、台湾地区，再向中国大陆的转移过程。目前，中国大陆已成为全球最大的 PCB 生产基地，拥有完整的产业链和成本优势。未来，随着新兴市场的崛起，产业可能进一步向具有成本和技术优势的地区转移，同时供应链也将更加多元化和区域化。

PCB 行业呈现出一定的集中化趋势，头部企业在技术研发、资金实力、客户资源等方面具有明显优势，能够更好地应对市场变化和竞争挑战。头部企业通过不断扩大产能、提升技术水平和拓展市场份额，进一步巩固了其市场地位。

中低端PCB市场，由于进入门槛相对较低，竞争较为激烈，企业主要通过价格战来争夺市场份额。而在高端市场，如高多层板、高频高速板、封装基板等领域，技术壁垒较高，企业需要不断投入研发，提升产品质量和性能，以差异化竞争获取市场份额。

中国台湾拥有完善的PCB产业链，从上游的覆铜板、铜箔、玻纤布等原材料生产，到中游的PCB制造，再到下游的电子组装和应用，包括终端客户的认证等各方面都具备很强的优势和竞争力。完善的产业链配套体系使得台湾 PCB产业在全球范围内都具有很强的竞争力。因此，中国台湾PCB产业链上下游公司的营收具备一定的代表性，反映行业的发展趋势和景气度。

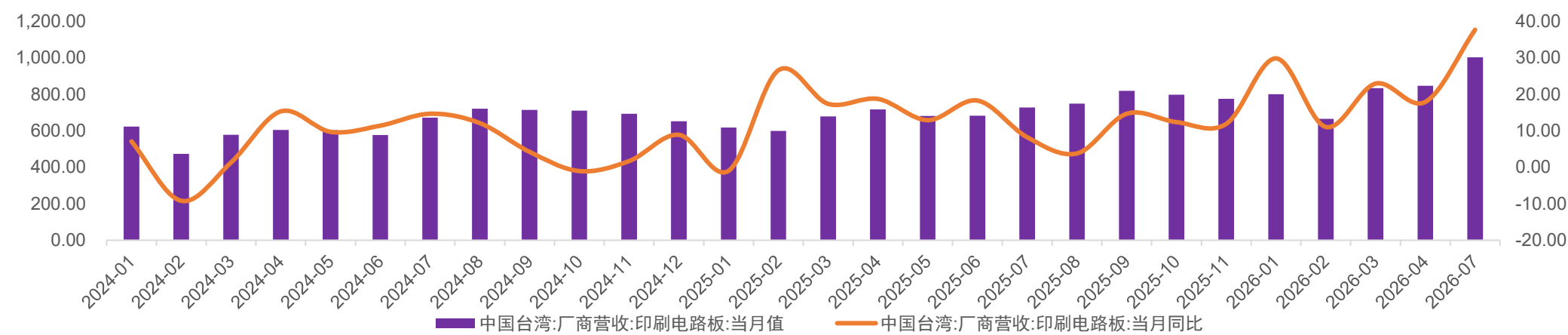
中游PCB厂商：从长期的维度来看，2023-2025年PCB行业经历了从衰退到复苏的阶段。2023年全年大部分月份营收同比增长率为负，行业处于衰退状态。但从2024年开始，同比增长率逐渐转正，行业进入复苏阶段，并在2025年行业整体实现了较为稳定的增长。这表明 PCB行业经历了一段下行时期之后，逐渐走出低谷，迎来了新的发展机遇。

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

从中期的维度来看，对比2024年和2025年的数据可以发现，行业从2024年初开始逐步复苏。2024 年 1 月台湾PCB厂商营收为 622.53 亿新台币，同比增长7.05%。2025年，台湾PCB厂商营收规模进一步扩大，增长率也保持在较高水平。尽管行业整体呈现增长趋势，但增长速度并不稳定。在2024年和2025年中，同比增长率都有较大幅度的波动，2024年2 月增长率为- 9.21%，之后又逐渐回升；2025年1月为- 0.99%，而2025年2月增长率为26.53%。波动的增长率反映出潜在的市场需求变化、季节性变化以及原材料价格波动等因素的影响。

从短期来看，下游AI算力需求旺盛带动AI-PCB需求提升。2024年以来，各月营收当月值整体处于较高水平，除 2024年2月为472.82亿新台币外，其余月份均在600亿新台币以上，且有个别月份超过 800 亿新台币。2025年11月，中国台湾PCB厂商营收达到774.72亿新台币，同比增长11.86%。2026年开年营收当月值处于较高水平，达到799.67亿新台币，同比增长29.77%。2026年7月当月值较开年营收进一步上升，达到 1011.13亿新台币，同比增长37.60%。

图表8：2023-2026年中国台湾印制电路板厂商营收及同比增速(亿新台币)



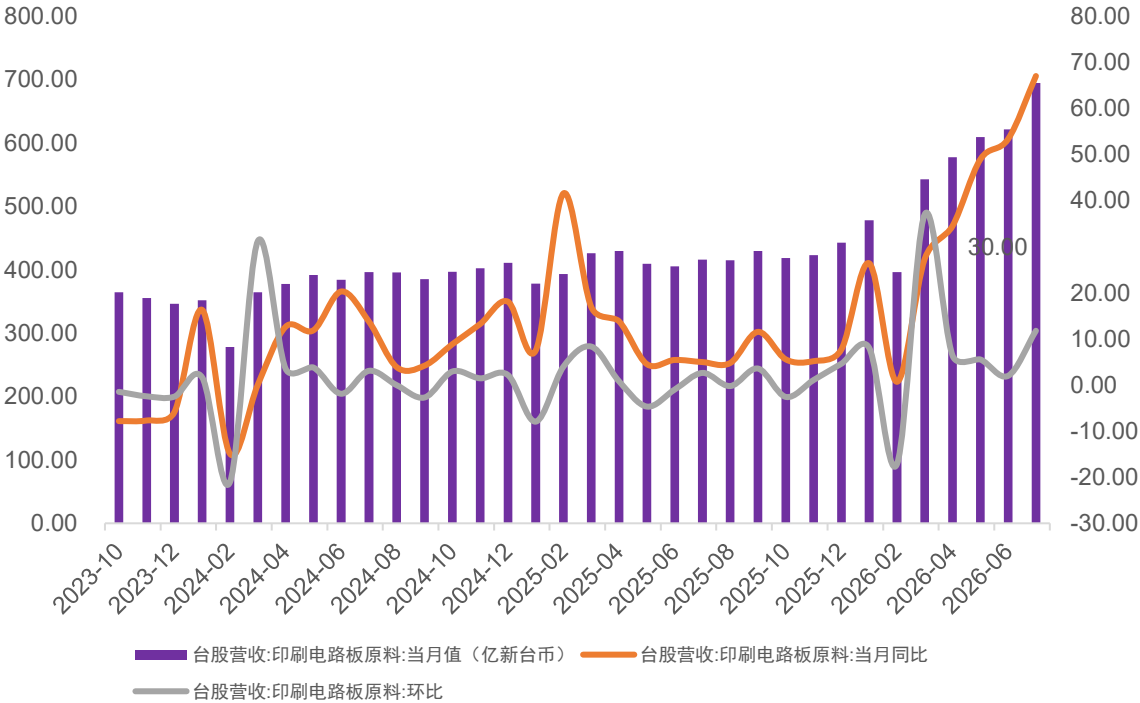
资料来源：wind，华鑫证券研究

1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

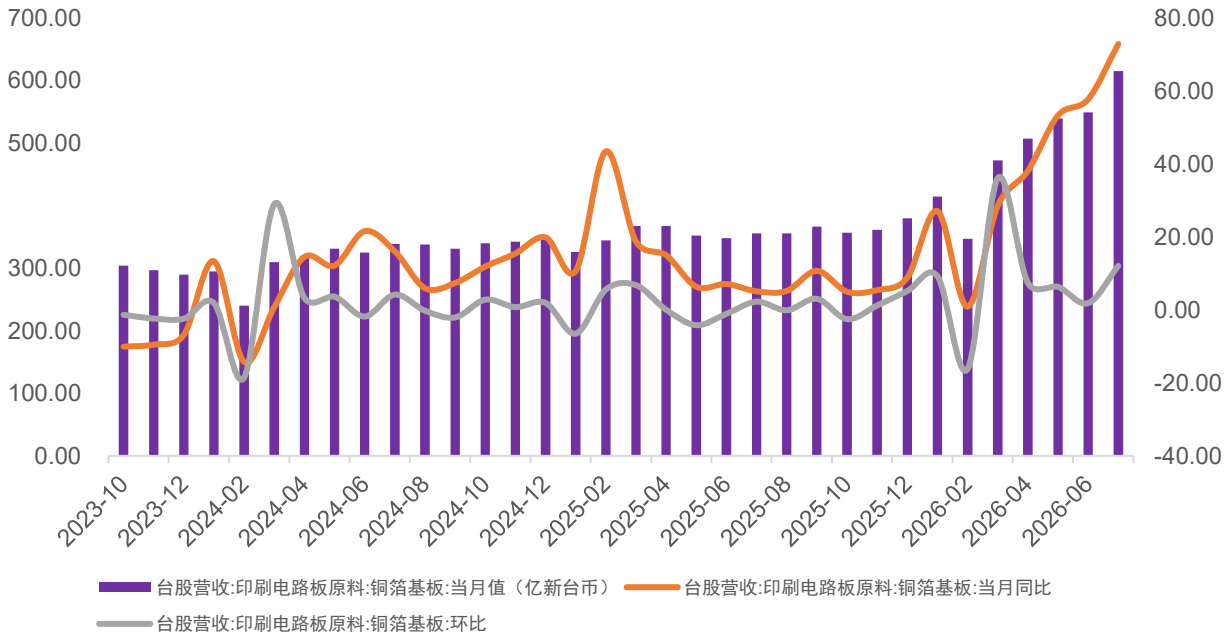
上游PCB基材厂商：5G、人工智能、汽车电子等新兴产业的发展对PCB上游基材提出新的要求，市场对于高频高速覆铜板和铜箔等材料的需求升级，M8-M9高频高速覆铜板和低表面粗糙度电子铜箔成为高端AI服务器的刚需。通常来说，PCB上游基材的市场需求存在一定的季节性变化，第一季度通常是需求淡季，第四季度可能是需求旺季。

从最新的数据来看，2026年7月，中国台湾PCB原料厂商实现营收694.57亿新台币，同比增长67.03%，环比增长11.76%；中国台湾铜箔基板厂商实现营收614.82亿新台币，同比增长72.82%，环比增长12.05%。

图表9：2023-2026年台湾印制电路板原料厂商营收及增速（亿新台币）



图表10：2023-2026年台湾铜箔基板厂商营收及增速（亿新台币）

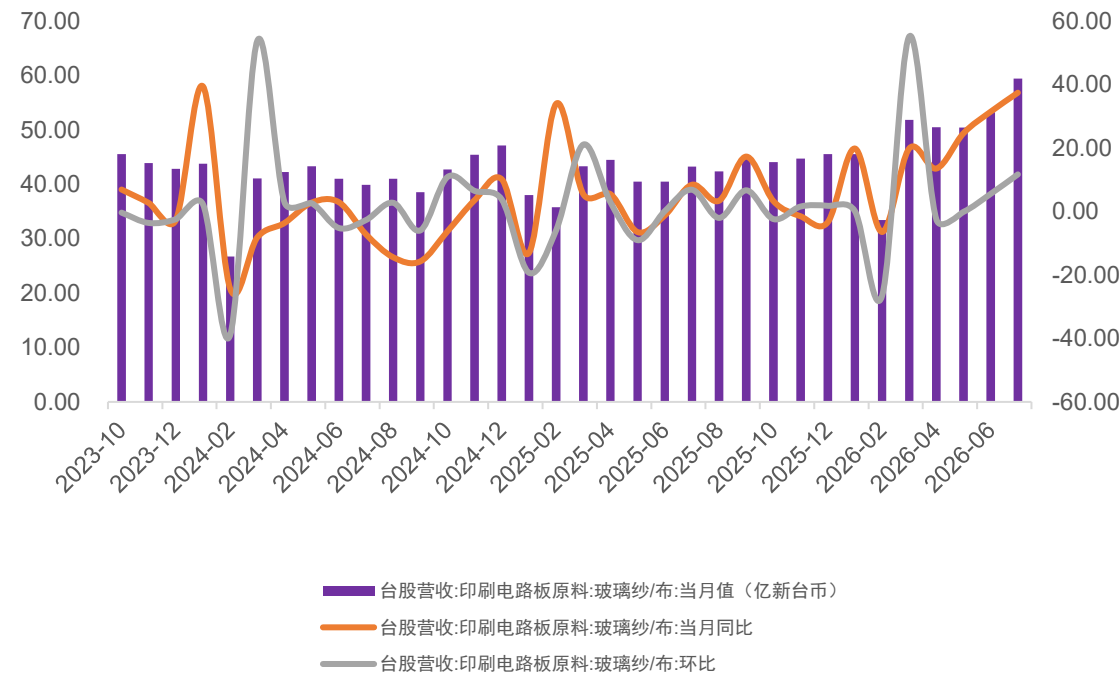


资料来源：wind，华鑫证券研究

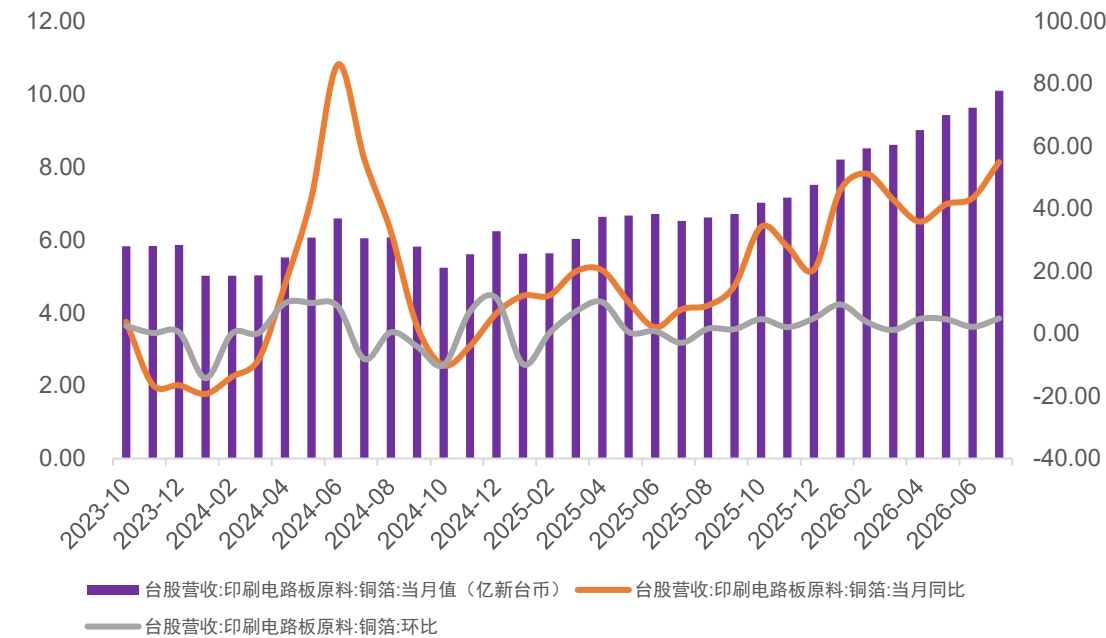
1.6、AI算力：PCB板块行情复盘

中国台湾电子布厂商实现营收59.38亿新台币，同比增长37.36%，环比增长11.65%；中国台湾电子铜箔厂商实现营收10.09亿新台币，同比增长54.87%；环比增长4.82%。

图表11：2023-2026年台湾电子布厂商营收及增速（亿新台币）



图表12：2023-2026年台湾电子铜箔厂商营收及增速（亿新台币）



资料来源：wind，华鑫证券研究

02 行业动态

研究创造价值

苹果首款2nm芯片发布

北京时间8月25日，苹果公司正式推出新一代Mac系列芯片——M6与M5 Ultra，将分别搭载于全新Mac mini和Mac Studio。

其中，M6是苹果首款2nm芯片，不仅带来了全球最快的单线程性能核心、更强的图形处理能力，还首次引入双16核神经网络引擎，大幅提升端侧AI能力；M5 Ultra则首次在M系列SoC中实现四芯片封装架构，将桌面芯片的性能与本地AI能力推向新高度。

M6是苹果首款采用2nm制程的芯片，这也为这款芯片性能和能效的提升打下了基础。

苹果硅工程集团副总裁Sri Santhanam在官方新闻稿中表示：“M6采用尖端的2nm工艺制造，结合了新的CPU复合体、额外的CPU和GPU核心、双16核神经网络引擎以及更高的统一内存带宽，能够以惊人的能效应对各种工作负载。”

CPU方面，M6引入了 M5 Pro/Max 那种新的“性能核”（Performance Core），其全新的12核CPU，包含2个超级核心（Super Core）、4个性能核心（Performance Cor）和6个能效核心（Efficiency Core）。超级核心核主要应对极重单线程任务，性能核心主要应对中重度多线程任务，能效核心则主要负责后台/轻任务。

■ 英伟达：2028财年营收将再涨70%

全球人工智能（AI）芯片龙头英伟达（NVIDIA）于美国东部时间8月26日美股盘后公布了截至2026年7月26日的2027财年第二季度财报，交出了一份全方位超越市场预期成绩单。

英伟达第二季总营收达到962.21亿美元（相当于Q2每天收入超10亿美元），同比增长106%，环比增长18%，不仅大幅超越公司自身指引中值910亿美元（±2%），更显著高于华尔街共识预期的约920亿美元。这已是英伟达连续第四个季度实现营收加速增长。

■ 富士通144核Monaka细节公布：2nm CPU与5nm缓存3D堆叠，明年量产

8月27日消息，在Hot Chips 2026大会上，日本科技大厂富士通正式揭开了其下一代数据中心处理器Monaka的神秘面纱。这款芯片采用了3D芯粒堆叠设计，计算核心采用了2nm制程Arm架构144核CPU，并支持256位SVE2、超低电压运行以及CCA（机密计算架构）。预计将于2027年正式量产发货。

富士通Monaka最核心的设计理念，是将昂贵的2nm先进制程用在最关键的“计算芯粒”，其他芯粒则采用5nm制程。具体来说，整个Monaka处理器被拆分为三个主要部分：

计算芯粒（Core Die）：采用台积电N2P（2nm）工艺，集成144个基于Armv9.3-A架构的自研CPU核心。

SRAM缓存芯粒（SRAM Die）：4个SRAM缓存芯粒均采用台积电N5（5nm）工艺，通过面对面的混合键合（Face-to-Face Hybrid Bonding）技术直接堆叠在4个计算芯粒下方，并且容纳了整个处理器的最后一级缓存（LLC）。

I/O芯粒（I/O Die）：同样采用5nm工艺，通过硅中介层（Silicon Interposer）与上方堆叠体相连，整合了内存控制器，并支持CXL 3.0 和PCIe 6.0 标准的连接信道。

Arm公布AGI CPU细节：Neoverse V3核心，晶体管超1000亿颗

在近日举行的Hot Chips 2026大会上，Arm首次详细披露了其成立36年来首款自研芯片——AGI CPU的完整架构细节。这款处理器并非传统意义上的通用CPU，而是针对AI智能体（Agentic AI）在工具调用、工作流程协调、规划与推理等工作负载所进行的定制化设计。

Arm AGI CPU基于Neoverse V3核心架构与Armv9.2指令集，采用台积电3nm工艺（N3P）打造。其最引人注目的设计是采用双芯粒（Dual Chiplet）方案，每个芯粒包含超过500亿颗晶体管，完整芯片晶体管总数突破1000亿颗。

在核心配置上，AGI ~~每个~~芯粒物理上搭载70个Neoverse V3核心，但各有4个核心被屏蔽以提升良率，因此单颗处理器最多启用136个核心，每核心配备2MB L2缓存，最高运行频率达3.7GHz，整体TDP上限为300W。

为满足AI智能体对低延迟内存访问的苛刻要求，Arm将内存与I/O集成在同一芯片上，将通信延迟控制在100纳秒以内。

AGI CPU还支持12通道DDR5内存，最高速率达8800 MT/s，内存带宽可达6GB/s，单芯片最大可支持6TB内存容量，并提供96条PCIe Gen6通道，兼容CXL 3.0扩展模块。

OpenAI自研芯片性能突破，吞吐量跃升

在备受关注的Hot Chips 2026大会上，OpenAI公布了其首款自研AI推理芯片“Jalapeño”（墨西哥辣椒）的首批独立基准测试结果。

数据显示，这款与博通（Broadcom）联合开发、功耗仅700W的专用集成电路（ASIC），在多项关键指标上大幅超越了英伟达（Nvidia）功耗高达1400W的GB300旗舰系统，为AI推理市场带来了新的变数。

Jalapeño是OpenAI在今年6月正式发布的一款专为当前及未来大语言模型（LLM）推理任务而从零开始设计的专用集成电路（ASIC）。主要涵盖ChatGPT、Codex和OpenAI的API应用。

据介绍，从项目启动到制造流片（Tape-out），Jalapeño仅用时9个月，号称是高性能ASIC领域最快的开发周期之一。这一速度得益于OpenAI工程团队与博通的深度软硬件协同，以及利用OpenAI自研的AI模型加速了部分设计与优化工作。

不过，当时OpenAI并未公布Jalapeño的具体参数，仅表示Jalapeño相比典型AI GPU展现出约50%的成本降低。

在本次Hot Chips 2026大会上，OpenAI透露，Jalapeño为减少数据移动和通信延迟，配备了6颗HBM4内存，总容量216 GB，该处理器额定功率为 700 瓦。

中芯国际上半年盈利接近翻倍，Q3仍有望维持高位

2026年上半年，全球AI基建与数据中心建设持续提速，大模型算力需求集中释放，算力芯片、高端存储芯片同步迎来量价齐升的上行周期，带动全球半导体产业产值大幅增长，产业链上下游协同配套能力持续优化。

作为国内规模领先的晶圆代工龙头企业，中芯国际（688981.SH/00981.HK）充分受益于AI需求从算力芯片向配套逻辑、电源管理及车规芯片持续外溢扩散，叠加产能稳步扩张、产品结构持续向高附加值节点升级，上半年经营业绩大幅向上，多项核心经营指标刷新历史记录。

8月27日，中芯国际发布2026年半年度报告。财报数据显示，上半年公司实现营业收入约386.35亿元，同比增长19.4%；实现归属于上市公司股东的净利润约44.67亿元，同比增长94.2%，盈利水平实现大幅跃升。

公司第二季度表现尤为亮眼：单季销售收入折合人民币215.40亿元（30.056亿美元），同比增长36.1%，环比增长20.0%，创下历史单季营收新高；毛利率25.3%，同比提升4.9个百分点，环比提升5.2个百分点；归属于本公司股东应占利润折合人民币34.30亿元（4.79亿美元），同比大幅增长42.7%，环比增长152.0%。

长鑫科技：上半年净利776亿元

8月28日晚间，国产DRAM龙头长鑫科技（688825.SH）交出了2026年半年报成绩单。

在AI算力需求爆发与全球DRAM供应紧缺的双重驱动下，长鑫科技2026年上半年实现营业收入1503.1亿元，同比暴增873.64%；归属于上市公司股东的净利润776.05亿元，而去年同期为亏损23.32亿元。这一业绩已远超公司2025年全年水平。

基于之前公布的一季度业绩计算，长鑫科技二季度归母净利润达528.43亿元，环比增长113%，增长势头极为迅猛。

长鑫科技在半年报中明确表示，上半年业绩爆发主要得益于“全球算力需求的快速增长和全球主要厂商产能调配等因素影响，全球DRAM产品供不应求，价格呈现大幅上涨趋势，带动公司主要DRAM产品销售毛利大幅增长”。

毛利率方面，长鑫科技上半年主营业务毛利率高达84.84%，远超上年同期水平。

现金流方面，长鑫科技上半年经营活动产生的现金流量净额达到1311.6亿元，同比暴增2985.64%，显示公司不仅账面盈利丰厚，现金流质量同样出色。

03 公 司 公 告

研究创造价值

润泽科技:2026年半年度报告

根据润泽智算科技集团股份有限公司2026年半年度报告。

报告期内，公司算力业务营业收入达19.95亿元，同比增长126.24%，占公司营业收入比例已达53.26%，超越机柜业务成为公司核心增长引擎。

报告期内，公司实现营业收入37.46亿元，同比增长50.05%；实现归属于上市公司股东的净利润12.03亿元，同比增长36.43%；实现经营活动产生的现金流量净额29.58亿元，同比增长30.78%。截至报告期末，公司总资产478.55亿元，较上年度末增长12.09%；归属于母公司所有者权益144.92亿元，较上年度末增长6.12%。报告期末，公司资产负债率为64.91%，财务状况保持健康态势。

公司高度重视股东回报。现金分红方面:公司自 2022 年重组上市以来，已合计派发现金分红超 36 亿元，同时根据公司股东会审议通过的相关议案，董事会提议派发 2026 年中期股息，拟以公司届时总股本扣除公司回购专用账户中股份数后的股本为基数，向可参与分配的股东按每 10 股派发现金红利 4.288 元(含税)，预计派发现金红利 6.99 亿元。股份回购方面:截至 2026 年 4 月 23 日，公司已通过回购专用证券账户累计回购 11,276,886 股公司股份，支付总金额约 5.58 亿元(不含交易费用)，本次回购股份已实施完毕。

紫光股份：紫光股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

根据紫光股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过43,000.0000万股（含本数）（即不超过本次发行前公司总股本的15.04%）。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次募集资金拟投资于收购新华三股权、研发设备购置及偿还银行贷款三个项目，项目投资总额合计54.12亿元，拟使用募集资金合计54.10亿元。

其中，公司拟使用募集资金33.90亿元用于收购新华三6.98%股权，该项目投资总额为33.91亿元；拟使用募集资金4.00亿元用于研发设备购置，项目投资总额为4.01亿元；此外，拟使用募集资金16.20亿元用于偿还银行贷款。

亚康股份:2026年半年度报告

根据北京亚康万玮信息技术股份有限公司2026年半年度报告

在报告期内，公司实现营业收入82,529.77万元,同比上升36.92%；归属于上市公司股东的净利润4,961.89万元，同比上升176.29%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,952.04万元，同比上升168.62%。从收入类型来看，算力设备集成销售业务收入28,067.37万元，占总收入的34.01%；算力基础设施综合服务收入46,757.04万元，占总收入的56.65%；数字化增值解决方案服务收入7,705.33万元，占总收入的9.34%。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

通富微电:2026年半年度报告

根据通富微电子股份有限公司2026年半年度报告。

得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行, 2026年上半年, 公司实现营业收入160.41亿元, 同比增长23.03%; 公司归属于上市公司股东的净利润17.17亿元, 同比增长316.77%。未来, 公司将持续深耕主业, 推进产能扩建、先进工艺落地与智能体系升级, 强化全球化协同优势, 稳固行业核心竞争力, 保障业务持续稳健增长。

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。公司向18名特定对象发行76,200,794股A股, 发行价格55.38元/股, 募集资金总额约42.20亿元, 实际募集资金净额约42.09亿元。截至8月26日募集资金已经到账并完成验资。

2026 年第二季度, AMD 数据中心部门的收入为 67 亿美元, 较上年同期的 32.4 亿美元增长 107%, 这主要得益于市场对 AMD EPYC 处理器和 AMD Instinct GPU 的需求;客户端与游戏业务部门营收 38 亿美元, 同比增长 6%;其中, 客户端业务营收为 31 亿美元, 较上年同期的 25 亿美元增长 23%, 主要受 AMD Ryzen 处理器需求推动。大客户 AMD 业务强劲增长, 也为公司的营收规模提供了有力保障。

■ 中科曙光:关于注销回购专用证券账户股份的公告

根据曙光信息产业股份有限公司关于注销回购专用证券账户股份的公告。

鉴于三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中 2023 年回购股份方案已回购但尚未使用的 784,041 股股份的用途进行调整，由“拟用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”，并提请公司股东会审议并授权公司后续按照相关规定办理股份注销手续，并相应减少公司注册资本。

本注销回购股份完成后，公司股本的变动如下：

本次股份变动前，公司总股本为1,463,115,784股。其中，有限售条件股份为61,440股，本次减少61,440股，变动后有限售条件股份为0股；无限售条件股份为1,463,054,344股，本次减少784,041股，变动后为1,462,270,303股。

本次股份合计减少845,481股，变动完成后，公司总股本由1,463,115,784股减少至1,462,270,303股。

04 风 险 提 示

研究创造价值

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

庄宇：清华大学硕士，金融学&工科复合背景。10年科技行业研究经验。立足产业，做深入且前瞻的研究，主要覆盖AI硬件领域。

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

王屿熙：

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券
CHINA FORTUNE SECURITIES

研创造价值